

御 得 意 様 各 位

無料 Web セミナー
Beyond 5G の実現に向けたパッケージ基板の技術動向

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、無料 Web セミナー「Beyond 5G の実現に向けたパッケージ基板の技術動向 ―当社が提案する
4つの新技術―」を5月25日に開催することとなりました。開催概要やご参加の方法は下記の通りとなります。

【開催概要】

5G からさらに進化した 6G に向けての技術革新が留まることなく進んでいます。その技術革新に欠かせないチップレット
化に向けて様々な技術課題があり、当社ではこの課題解決に貢献する新しい表面処理プロセスの開発に力を入れてお
ります。

ここでは微細回路形成技術のトレンドと当社の4つの新技術についてご説明いたします。

開催日：2023年5月25日（木）

時 間：11:00～（約30分）

費 用：無料

形 式：Web セミナー（Microsoft Teams 使用）

【お申込み方法】

下記リンク先のお申込みフォームよりご登録ください。

<https://www.meltex.com/registration.html>

なお、Web セミナーや、その他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせ
ください。

■お問合せフォーム

<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともよろしく願いたします。

敬具